

广东超华科技股份有限公司 关于与上海交通大学签署共建电子材料联合研究中心合作 协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署概况

为了促进下一代先进电子材料工艺技术的研发及其产业化，以及加强优秀人才的培养，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）于2019年6月21日与上海交通大学签订了共建电子材料联合研究中心合作协议（以下简称“协议”）。

本次协议签订不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次协议签订事项在总裁办公会的审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、协议对方基本情况

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过123年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。材料科学与工程学院是国内首批国家重点一级学科，连续多年入围ESI世界前1%学科，国内首批设立硕士点、博士点和博士后流动站。在2018年QS世界排名中名列国际第25名。

上海交通大学与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

甲方：广东超华科技股份有限公司

乙方：上海交通大学

（一）合作期限

本协议合作期为五年。

（二）合作方式

上海交通大学—广东超华科技电子材料联合研究中心以共同研发、申报项目为基本形式，依托上海交通大学材料科学与工程学院的雄厚理论技术和丰富研究成果，与广东超华科技在高精度电子铜箔、覆铜板和印制电路板（PCB）领域的未来发展需求、基础技术研究、中试研究、产业化合作以及人才培养和技术指导等方面展开全面合作。主要集中在以下方面：

1. 科研合作

（1）重点研究下一代先进电子材料的工艺技术及其产业化；

（2）甲、乙双方将根据国家、省市相关项目申报指南，联合申报和开展科研项目研究，争取国家、省市资金支持；

（3）积极筹建上海交通大学（梅州）研究院，具体事项在研究院设立时另行协商。

2. 人才培养

（1）乙方可根据甲方需求，为甲方组织有针对性的培训，协调甲方高级管理及行政人员在上海交通大学进行相关培训；

（2）乙方负责组织双方科研及技术人员参加各类国内外学会、协会活动；

（3）甲方为乙方在校学生提供实习基地。乙方通过多种途径推荐优秀毕业生到甲方就业。

（三）研究内容

1. 高频高速（5-10G）铜箔及基板材料关键工艺技术研究；

2. 锂电铜箔关键工艺技术研究；

3. 大功率电子铜箔工艺技术及应用研究；

4. 先进电子产品可靠性研究。

（四）双方的权利与义务

1. 甲方按时根据本协议约定向乙方提供研究经费；

2. 甲方积极推进研究院的成立；

3. 甲方需积极配合研究中心在研发过程中调研、共同研讨、测试、中试以及其他必要的需求；

4. 研究中心在研发中所需的但双方均不保有的必要的研发、测试设备，在领导小组联席会议上批准后，甲方需积极提供；

5. 甲方根据研究中心需要提供办公场所以及办公条件。甲方协助提供食宿条件供乙方来中心工作人员使用；

6. 其他研发过程中的便利包括但不限于人力资源、水电、燃料、测试材料等，甲方需积极提供。同时，做好安全保障措施；

7. 乙方积极推进上海交通大学（梅州）研究院的组建；

8. 乙方根据研究中心需要推荐研究人员，遴选研发课题以及推动研发；

9. 乙方在研发过程中需要影响甲方生产经营活动，报告领导小组联席会并征得同意后方可实施；

10. 乙方提供保有的研发测试设备供研究中心使用，使用过程按照甲方内部人员待遇并遵循乙方相关规定；

11. 研究中心在研发过程中须遵循尽力尽责以及勤勉义务；

12. 乙方研发人员在甲方工作时，须遵守甲方的公司内部规定，并做好相关安全保障措施。

（五）合作经费

合作期内，甲方每年提供不少于 300 万人民币的科研经费。

四、对公司的影响

公司此次与上海交通大学签署共建电子材料联合研究中心合作协议，有利于充分发挥各自的优势，以产学研相结合的方式进行电子材料领域的研发，有利于公司抓住行业发展机遇，夯实行业地位，完善产品结构，提升产品竞争力。同时，借助上海交通大学雄厚的研发实力，通过开展学术及技术等方面的交流合作，帮助公司培养研发团队，提升公司的专业技术水平。

本次协议的签订短期内对公司的财务状况和经营成果不会构成重大影响，长期将对公司经营成果带来积极影响。

合同签订对公司业务独立性不造成影响。

五、风险提示

在合作过程中，相关技术开发能否成功具有不确定性，相关技术成果的产业化转移存在市场风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日